

Опитувальний лист для вибору дискової заслінки (батерфляй)



Назва підприємства: _____

Контактна особа, тел., email.: _____

1. Умовний прохід: _____

2. Тип заслінки – (Wafer) / (Lug)

3. Вимоги до матеріалів:

- корпус _____
- диск _____
- ущільнення _____
- наявність футерування (дод. обробка/покриття поверхні) _____

4. **Робоче середовище:** (фізичний стан, щільність, можливість налипання, в'язкість, агресивність, токсичність, вибухонебезпека, пожежонебезпека). Наявність в робочому середовищі механічних домішок (в мг/л, найбільший розмір частинок в мкм, їх склад та твердість). _____

5. **Тиск робочого середовища** (розмірність, залишковий по відношенню до навколишнього середовища або надлишковий):

- на вході: _____
- на виході: _____
- перепад тиску: _____

6. **Витратна характеристика:**

- максимальна та мінімальна витрата робочого середовища _____
- вид пропускної характеристики: _____
- швидкість потоку робочого середовища: _____

7. **Температура робочого середовища, °C:**

- максимальна: _____
- мінімальна: _____

8. **Швидкість:**

- відкривання: _____
- закривання: _____
- періодичність спрацювання: _____
- частота спрацювання за одиницю часу: _____

9. **Герметичність, клас герметичності** _____

10. **Характеристика навколишнього середовища:**

- температура від _____ до _____ °C:
- вибухонебезпека (категорія вибухозахисту): _____

11. **Призначення та умови роботи арматури в установці:** _____
(запірна, регулююча)

12. **Положення запірної елементу при відсутності сигналу:** _____
(закритий (N.C.), відкритий (N.O.), без змін (DA))

13. **Привід запірної елементу:** _____
(ручний; електричний; пневматичний – одно-/двосторонньої дії; ручне дублювання – так/ні)

14. **Тиск керування приводом** _____ бар; **Напруга привода** _____ V AC/DC

15. **Наявність датчиків кінцевого положення** _____

16. **Необхідність позиціонування (4-20mA) / зворотний зв'язок:** _____ / _____
(так, ні)

Додаткові вимоги: _____

Примітка: _____

